

▶ **세미나명 :**

**전자기기 고발열 대응 [심층분석]- 최신 방열 솔루션 기술 소개 및 추진전략 세미나**  
-삼성과 현장에서 윈윈·협력 상담 가능/국내외 방열 구조·소재·부품 중심-

▷ **개최배경 :**

AI 반도체·전력전자·전기차 확산으로 전자부품 산업은 전환기에 들어서고 있습니다. 더불어 고발열·고신뢰 환경에서 패시브 부품과 패키징·소재 기술이 성능을 좌우하며 글로벌 경쟁은 고기능 구조 설계와 소재 혁신, 공급망 주도권으로 확대되고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 산업교육연구소에서는 **삼성전자의 방열 소재 분야에서 축적된 오랜 연구 경험과 국제적 R&D 분석 경험을 보유하신 전문가님을 모시고** 최신 방열 솔루션 기술을 소개하고 관련한 전략 추진을 위한 방법을 모색하고자 본 세미나를 개최합니다.

▶ **일 시 :**

2026년 02월 27일(금) 10:00~14:30

▷ **장 소 :**

KIETI 세미나실 (서울 구로동) & 온라인 실시간 방송

\* 현장 인원에 따라 세미나 진행 장소는 변경될 수 있습니다.

\* 신청 전 홈페이지([www.kiei.com](http://www.kiei.com))에서 개최 장소를 반드시 확인해주시기 바랍니다.

▶ **주 최 :**

산업교육연구소

▷ **프로그램 :**

1. Passive 방열 솔루션을 위한 방열 구조/소재/부품 (1)
2. Passive 방열 솔루션을 위한 방열 구조/소재/부품 (2)
3. Thermal Packaging을 위한 방열 구조/소재/부품
4. 글로벌 기업들의 방열 기술동향과 차별화 전략

\* 프로그램 세부 내용은 변경될 수 있습니다.

\* 실제 현 프로그램 상세내용과 세부 목차는 홈페이지에서 확인 가능합니다.

▶ **등록방법 :**

산업교육연구소 홈페이지([www.kiei.com](http://www.kiei.com)) → 신청서 작성

\* 전화 등록도 가능하지만 인적사항 작성의 정확성을 위하여 이메일 혹은 온라인 등록을 권장합니다.

※ **문의처 :**

이메일([kieiseminar@kiei.com](mailto:kieiseminar@kiei.com)) 또는 전화(02-2025-1333~7) 문의 바랍니다.